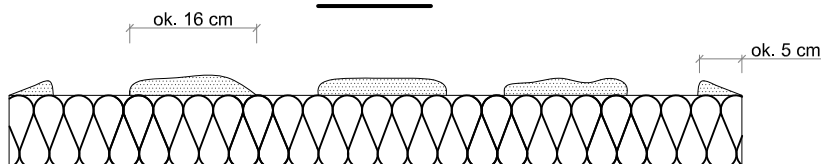


**A - A**



Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych.

Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.

Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40 % efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% \geq 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

**BM art Projekt**

Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14

**Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej  
przy Zespole Szkół w Piątkowej**

Branża	Architektura - projekt wykonawczy		Numer rysunku
Przedmiot rysunku	Sposób klejenia płyt styropianowych		<b>A-25</b>
Investor	<b>Gmina Chełmiec</b>		Skala rysunku
Adres budowy	<b>Piątkowa gm. Chełmiec dz. nr 616</b>		<b>1:20</b>
Projektował	mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz	nr upr. SW-36/2007 specjalność architektoniczna	Data 09.2008
Opracował	mgr inż. Mateusz Rolecki	_____	Data 09.2008
			Podpis